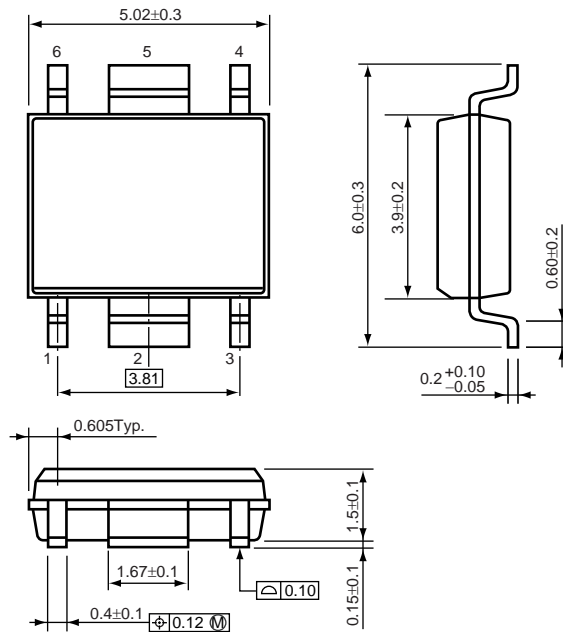


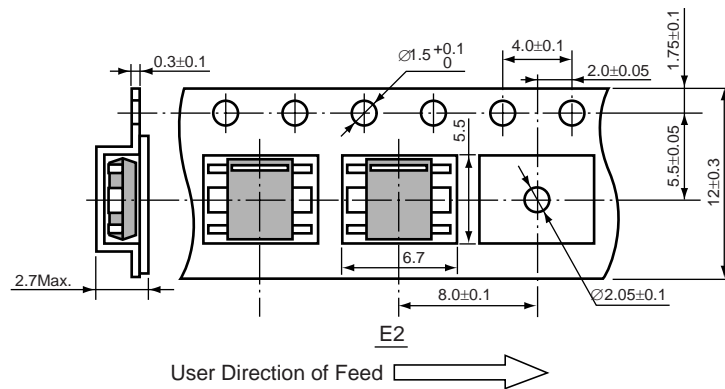
HSOP-6J

単位: mm

■ パッケージ外形図

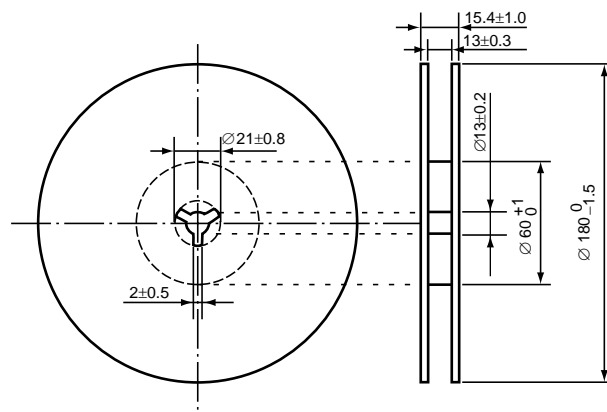


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リユースリール(EIAJ-RRM-12Bc)

(1リール=1,000個)



### ■ 許容損失について (HSOP-6J)

HSOP-6Jパッケージの許容損失について特性例を示します。

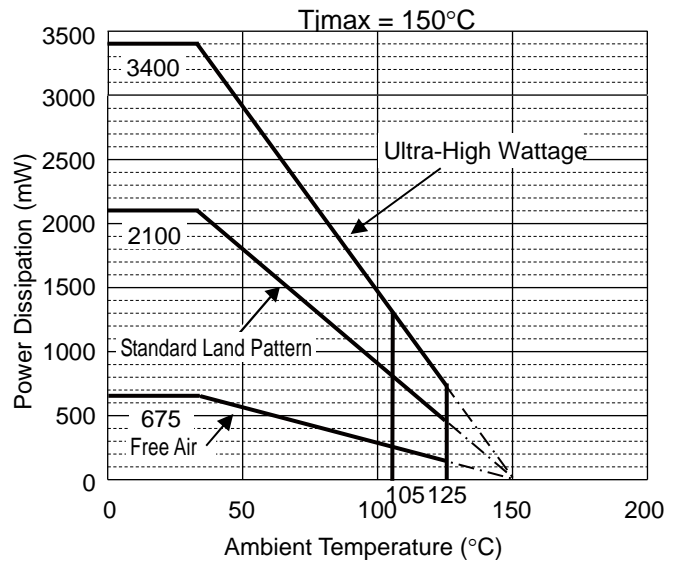
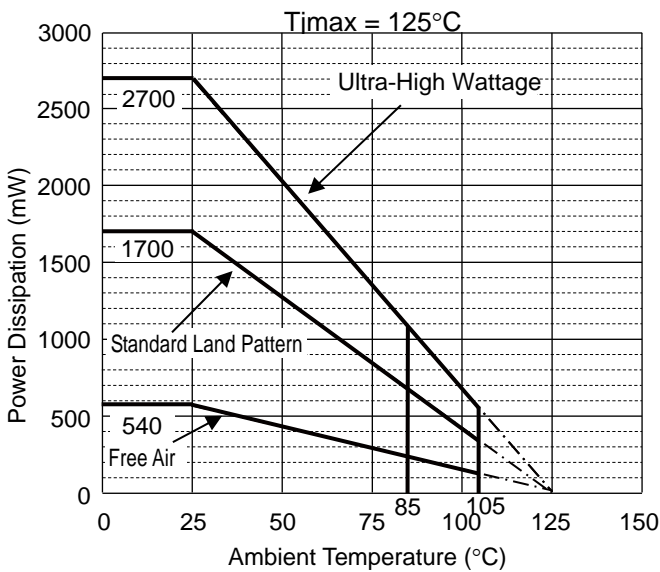
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

測定条件

	標準実装条件	超ハイワットテージ実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)	ガラスエポキシ樹脂 (4層基板)
基板サイズ	50 mm × 50 mm × 1.6 mm	76.2 mm × 114.3 mm × 0.8 mm
配線率	50%	96%
スルーホール	直径 0.5 mm × 24 個	直径 0.3 mm × 28 個

測定結果 (Ta = 25°C)

	単体宙吊り	標準実装条件	超ハイワットテージ実装条件
許容損失	540 mW (Tjmax = 125°C) 675 mW (Tjmax = 150°C)	1700 mW (Tjmax = 125°C) 2100 mW (Tjmax = 150°C)	2700 mW (Tjmax = 125°C) 3400 mW (Tjmax = 150°C)
熱抵抗値	$\theta_{ja} = 185^\circ\text{C/W}$ $\theta_{jc} = 17.5^\circ\text{C/W}$	$\theta_{ja} = 59^\circ\text{C/W}$	$\theta_{ja} = 37^\circ\text{C/W}$



許容損失 対 周囲温度

### ■ 基板パッド推奨寸法

